



(45)授权公告日 2018.02.23

权利要求书1页 说明书2页 附图1页

1. 一种应用于电脑处理器的散热结构, 固定连接在机箱壳体与处理器之间, 其特征在于, 所述散热结构包括多根导热管、用于将所述导热管固定在所述机箱壳体上的壳体固定座和用于将所述导热管固定在处理器上的处理器固定座, 所述导热管一端连接所述壳体固定座, 所述导热管另一端连接所述处理器固定座; 所述处理器固定座上开设有与所述导热管相对应的多个固定槽, 每一所述导热管对应焊接固定在所述固定槽上; 所述导热管所在平面与所述处理器固定座所在平面贴平。

2. 如权利要求1所述的应用于电脑处理器的散热结构, 其特征在于: 所述壳体固定座采用螺丝固定安装在所述机箱壳体上, 所述导热管焊接固定在所述壳体固定座上。

3. 如权利要求1-2任一项所述的应用于电脑处理器的散热结构, 其特征在于: 所述导热管为铜管。

一种应用于电脑处理器的散热结构

技术领域

[0001] 本发明涉及电子设备领域,尤其涉及一种应用于电脑处理器的散热结构。

背景技术

[0002] 目前,市面上一般电脑处理器散热器是采用散热器加散热风扇构成,讲散热器用扣具安装在处理器上,散热风扇安装在散热器上并连接电源,当计算机运行时,散热器不断将处理器表面高温带出,由散热风扇把这些热量立即吹走,以此实现为处理器散热降温的目的。目前的问题是,随着处理器运算时钟频率不断提升同时产生高耗电和高热,会影响系统产品的稳定和使用寿命,至今未找到最佳解决途径,被迫把散热器和散热风扇的体积越做越大,产生的噪音也因此加重。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服现有技术之缺陷,提供了一种结构简单、成本低、无噪音、散热效果好的应用于电脑处理器的散热结构。

[0004] 本发明是这样实现的:一种应用于电脑处理器的散热结构,固定连接在机箱壳体与处理器之间,所述散热结构包括多根导热管、用于将所述导热管固定在所述机箱壳体上的壳体固定座和用于将所述导热管固定在处理器上的处理器固定座,所述导热管一端连接所述壳体固定座,所述导热管另一端连接所述处理器固定座;所述处理器固定座上开设有与所述导热管相对应的多个固定槽,每一所述导热管对应焊接固定在所述固定槽上;所述导热管所在平面与所述处理器固定座所在平面贴平。

[0005] 进一步地,所述壳体固定座采用螺丝固定安装在所述机箱壳体上,所述导热管焊接固定在所述壳体固定座上。

[0006] 进一步地,所述导热管为铜管。

[0007] 本发明提供一种应用于电脑处理器的散热结构,通过导热管一端连接壳体固定座,导热管另一端连接处理器固定座,处理器安装固定在处理器固定座上,随着处理器运算时钟频率不断提升同时会产生高耗电和高热,热量可由处理器固定座传导至所述导热管上,进而通过壳体固定座将热量传导到机箱壳体上,使得处理器的散热效率较高,且工作温度不受外界环境的影响,不但有利于保证处理器的正常工作,提高电脑的性能,同事,也使得电脑能够适应较高环境的工作,此散热结构结构简单、成本低,可节省电脑内空间,不会产生噪音,散热效果好。

附图说明

[0008] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0009] 图1为本发明实施例提供的散热结构安装在机箱壳体上的立体图；

[0010] 图2为本发明实施例提供的散热结构安装在机箱壳体上的另一立体图。

具体实施方式

[0011] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0012] 如图1-图2，本发明实施例提供一种应用于电脑处理器的散热结构1，固定连接在机箱壳体2与处理器(图未示)之间，所述散热结构1包括多根导热管11、用于将所述导热管11固定在所述机箱壳体2上的壳体固定座12和用于将所述导热管11固定在处理器上的处理器固定座13，所述导热管11一端连接所述壳体固定座12，所述导热管11另一端连接所述处理器固定座13。处理器安装固定在处理器固定座13上，随着处理器运算时钟频率不断提升同时会产生高耗电和高热，热量可由处理器固定座13传导至所述导热管11上，进而通过壳体固定座12将热量传导到机箱壳体2上，使得处理器的散热效率较高，且工作温度不受外界环境的影响，不但有利于保证处理器的正常工作，提高电脑的性能，同事，也使得电脑能够适应较高环境的工作，此散热结构1结构简单、成本低，可节省电脑内空间，不会产生噪音，散热效果好。

[0013] 进一步地，如图1、图2，所述处理器固定座13上开设有与所述导热管11相对应的多个固定槽131，所述处理器固定座13采用铜或铝材质成型，其导热性能好；本实施例中，所述导热管11具有两条，所述处理器固定座13上设有两个所述固定槽131，每一所述导热管11对应焊接固定在所述固定槽131上，焊接稳固，所述导热管11所在平面与所述处理器固定座13所在平面贴平，可保证良好的导热性能，同时节省空间。需要说明的是，所述导热管11的数量可根据需求灵活设计，所述固定槽131根据所述导热管11的数量对应设计。进一步地，所述导热管11为铜管，其导热效果好、成本低。

[0014] 进一步地，如图1、图2，所述壳体固定座12采用螺丝固定安装在所述机箱壳体2上，此种安装方式安装方便、便于拆卸；所述导热管11焊接固定在所述壳体固定座12上，使得结构比较稳固；所述壳体固定座12采用铜或铝材质成型，其导热性能好。

[0015] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

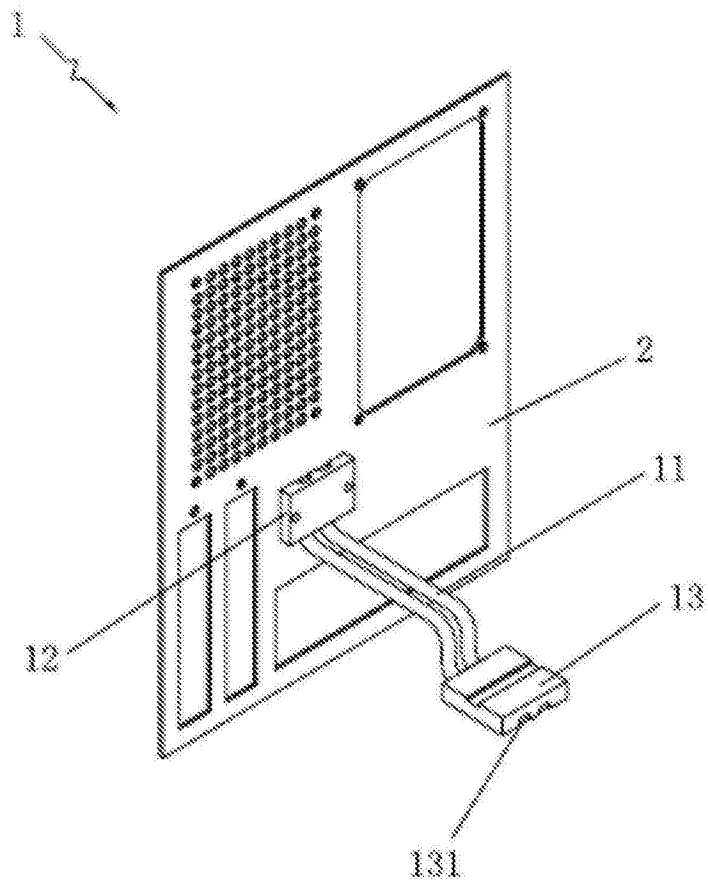


图1

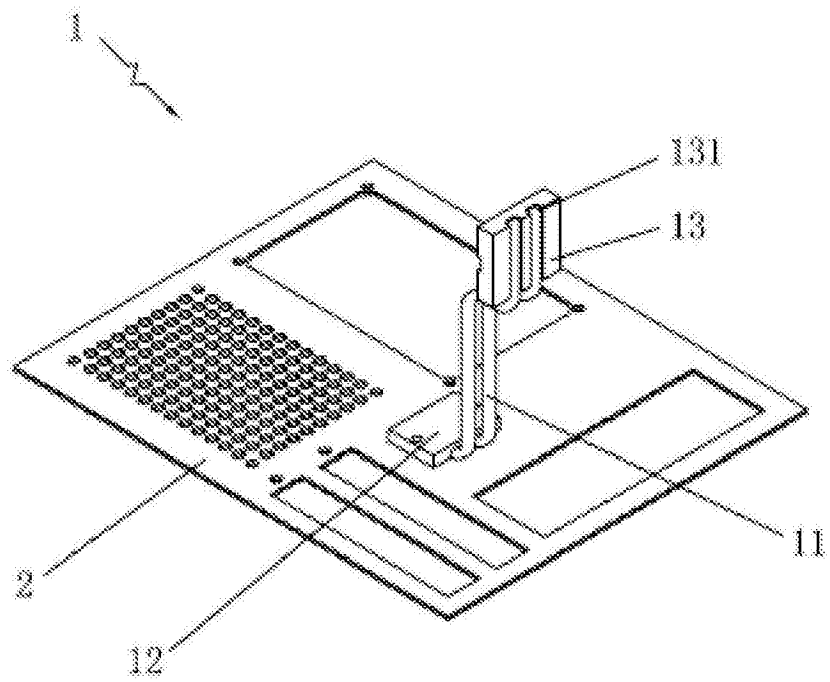


图2